

中国国际金融股份有限公司

关于终止对上海超硅半导体股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之辅导工作的公告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与上海超硅半导体股份有限公司（以下简称“上海超硅”）于2021年6月签订了《上海超硅半导体股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），约定中金公司担任上海超硅首次公开发行股票并在科创板上市的辅导机构，并向中国证券监督管理委员会上海监管局报送了首次公开发行股票并在科创板上市的辅导备案申请文件。

上海超硅基于自身战略考量，拟对上市计划进行调整，经与中金公司友好协商，双方同意解除《辅导协议》，并签署《关于上海超硅半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之终止辅导协议》。根据上述协议，中金公司终止对上海超硅首次公开发行股票并在科创板上市的辅导工作。

特此公告。

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于终止对上海超硅半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之辅导工作的公告》的盖章页)

